

## IBM encuentra la forma de refrigerar los chips en funcionamiento

### IBM encuentra la forma de refrigerar los chips en funcionamiento

Los científicos del laboratorio de Zurich de IBM han desarrollado una técnica de pegado que, utilizada para ensamblar los procesadores, consigue mantenerlos refrigerados mientras están en funcionamiento.

Los pegamentos se utilizan para ensamblar los paquetes de semiconductores, como los microprocesadores y los chipsets, con elementos de refrigeración que dispersan el calor generado por la potencia de los chips. Hasta el momento, los pegamentos actuales contienen partículas microscópicas de cerámica y metal que facilitan la transmisión del calor, explica IBM.

Los científicos han descubierto que el problema radica en la manera en la que se aplica este pegamento. Han observado que cuando un procesador se pega a un elemento de refrigeración del paquete del semiconductor, la junta que se forma con el pegamento hace que las partículas microscópicas se apilen en él y no se expandan. Para evitar este problema, los científicos han creado pequeñas ranuras en la base del disipador para que el pegamento pueda fluir libremente. El resultado es una capa más fina de pegamento que dispersa el calor tres veces mejor, señala IBM.